

平成 25 年 2 月 7 日

各 位

会社名 富士通株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山本 正巳  
(コード番号 6702 東証第一部)  
問合せ先 広報 IR 室長 山守 勇  
(TEL. 03-6252-2175)

会社名 富士通セミコンダクター株式会社  
代表者名 代表取締役社長 岡田 晴基  
問合せ先 経営戦略室長 貫和 拓司  
(TEL. 045-755-7009)

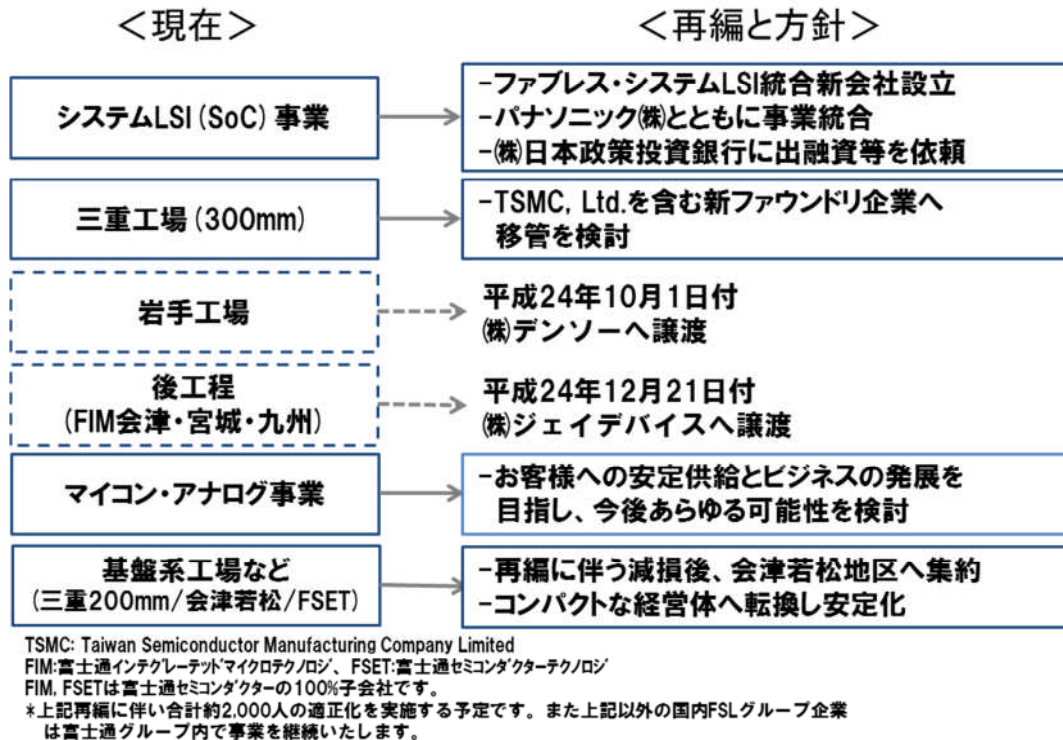
## 半導体事業の再編と方針について

富士通株式会社（以下、富士通）と富士通セミコンダクター株式会社（以下、富士通セミコンダクター）は、本日、「半導体事業の再編と方針」をまとめました。

### 1. 半導体事業の再編と方針について

富士通と富士通セミコンダクターは、平成 21 年度より独自のファブライツ事業モデルを追求した半導体事業を推進してきました。しかし平成 23 年度以降、市況の急激な悪化や競争環境の変化により売上が減少するなど、極めて厳しい環境に直面しております。こうした中で、富士通セミコンダクターの岩手工場・LSI 後工程事業の譲渡などの対応を取り、ファブライツ戦略を加速してまいりました。また半導体事業のさらなる発展に向けて、富士通と富士通セミコンダクターがこれまで培ってきた技術・ノウハウをベースとしてより良い事業体制を構築するために、他社との協議も含めて様々な検討を進めてまいりました。

今般、システム LSI 事業でのファブレス新会社設立・富士通セミコンダクターとパナソニック株式会社（取締役社長：津賀 一宏、本社：大阪府門真市、以下、パナソニック）のシステム LSI 事業の統合、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited(以下、TSMC)を含む新ファウンドリ企業への三重工場の移管という方針を決定し、具体的な検討に入りました。今後、富士通のシステム LSI 事業は、統合により事業規模を拡大して独立した企業として運営されることになります。またマイコン・アナログ事業はお客様への安定供給とビジネスの発展を目指し、今後、あらゆる可能性を検討してまいります。さらに再編に伴う固定資産の減損を行った後で、稼働率の改善が課題となっている基盤系工場などは会津若松地区へ集約して生産能力や人員規模の適正化を行い、コンパクトな事業体へ転換して経営を安定化してまいります。



(1) システム LSI 事業でのファブレス新会社設立、および富士通セミコンダクターとパナソニックのシステム LSI 事業の統合について

富士通とパナソニックは、外部投資家の出資を得て、システム LSI の設計・開発などを手掛けるファブレス形態の新会社を設立し、富士通セミコンダクターおよびパナソニックのシステム LSI 事業の設計・開発機能などを新会社へ事業移管することを基本合意しました。当該新会社の設立にあたっては、株式会社日本政策投資銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋本 徹）に新会社への出融資等をお願いしております。

新会社は、独立した事業体として、①ハイパフォーマンス・ソリューション、②イメージング・ソリューション、③ワイヤレス・ソリューションなどにおいてグローバルトップレベルのシステム LSI カンパニーとなることを目指します。

\*詳細は「システム LSI 事業の統合新会社設立に関する基本合意について」参照

(2) 三重工場 300mm ラインについて

昨今、世界の LSI メーカーは回路の設計開発に特化したファブレス企業と、受託製造のファウンドリ企業に専門化が進んでおります。富士通セミコンダクターは、平成 21 年度に独自のファブライต์事業モデルへ転換したことを機に、TSMC との間で 40nm 以降の先端プロセステクノロジーを用いたシステム LSI 製品に関して強いパートナーシップを築いてまいりました。今般、上記 (1) のシステム LSI 事業のファブレス化に伴い、三重工場 300mm ラインも TSMC を含む新ファウンドリ企業へ移管することを検討しています。国内外のお客様に高品質で先進の半導体製品を安定的に提供するとともに、グローバルな半導体市場において高い競争力を発揮し、持続的に発展できる新しい事業モデルを検討していきます。

### (3) マイコン・アナログ事業について

富士通セミコンダクターは、これまでマイコン・アナログ事業に関して、車載、産業、民生向け汎用 MCU、パワーマネジメント LSI などに注力し、新商品投入や販売チャネルの拡充などの施策を展開しております。お客様への安定的な供給とビジネスの発展を目指し、今後、あらゆる可能性を検討して進めてまいります。

### (4) 再編後の経営安定化方針について

富士通セミコンダクターが持つ製造拠点は、システム LSI 統合新会社の設立と現在検討中の三重工場 300mm ラインの移管の後、基盤系の三重 200mm ライン、会津若松 150mm ライン、富士通セミコンダクターテクノロジー(代表取締役社長:堀 仁、本社:福島県会津若松市) 200mm ラインとなります。今般の事業再編の方針の決定により固定資産を減損します。減損の後、稼働率の改善が課題となっている基盤系工場は、会津若松地区へ集約し、生産能力や人員規模の適正化を行い、稼働率を向上させて経営を安定化させます。

事業再編の方針の決定に伴う適正化の総人員規模は、富士通セミコンダクターグループ全体で約 2,000 名になります。今後、コンパクトで効率的な経営体制へ転換すると共に、お客様へ従来通りの品質とサービスを提供してまいります。

## 2. 当社業績（連結・単独）への影響について

上記「1. 半導体事業の再編と方針」が当社連結業績に与える影響として、平成 25 年 3 月期 第 3 四半期に特別損失 570 億円を計上しており、第 4 四半期においても約 550 億円を見込んでいます。

また単独業績予測に与える影響として、平成 25 年 3 月期第 3 四半期に、関係会社株式評価損 1,654 億円を計上しました。第 4 四半期においても引き続き半導体事業の構造改革を進めるため、富士通セミコンダクター株式会社については、追加の株式評価損が発生する可能性があります。

以 上

(注)本資料に記載されている業績見通しなどの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績などは様々な要因により大きく異なる可能性があります。